

[별지서식 2] 교육과정표

첨단반도체공정장비 융합전공

이수 구분	학수번호	교과목명	학점 (시간)	이론/실습	비고
전공 필수	EIEN346	센서공학	3(3)	이론	
	EMSE335	CAD	3(3)	이론	
	EIEN234	AI-빅데이터공학수학	3(3)	이론	
	SPHY375	반도체공정 및 실습캡스톤디자인	3(5)	이론및실습	택 1
	EIEN320	반도체제작기술	3(3)	이론	
전공 선택	EIEN378	광공학	3(3)	이론	
	EIEN342	패턴인식과기계학습	3(3)	이론	
	SPHY411	열물리학	3(3)	이론	
	SPHY477	공정플라즈마개론	3(3)	이론	
	SPHY478	플라즈마공정및장비	3(3)	이론	공정플라즈마개론 선이수
	EMSE309	계측공학 I	3(3)	이론	
	EMSE346	진동공학	3(3)	이론	
	EMSE246	마이크로프로세서	3(3)	이론	디지털시스템 선이수
	ASPE310	진공공학	3(3)	이론	
	SPHY379	반도체계면공정	3(3)	이론	
	AISE303	마이크로프로세서응용	3(3)	이론	
	AISE401	광메카트로닉스	3(3)	이론	
	AISE403	반도체자동화시스템	3(3)	이론	
	EIEN461	디지털통신	3(3)	이론	
	AISE405	반도체 패키지 및 테스트	3(3)	이론	
	AISE407	반도체소자 시뮬레이션	3(4)	이론	
	EICI201	KUS 전공특화현장실습 I	3(0)	인턴십	
	EICI202	KUS 전공특화현장실습 II	3(0)	인턴십	
	EICI203	KUS 전공특화현장실습 III	3(0)	인턴십	
	EICI204	KUS 전공특화현장실습 IV	3(0)	인턴십	
	EICI205	KUS 전공특화현장실습 V	3(0)	인턴십	
	EICI206	KUS 전공특화현장실습 VI	3(0)	인턴십	
	ASPE410	세정장비이론 및 캡스톤디자인	3(4)	이론및실습	
	ASPE412	식각장비이론 및 캡스톤디자인	3(4)	이론및실습	
	ASPE413	차세대식각공정장비이론 및 실습	3(4)	이론및실습	
	ASPE414	박막증착장비이론 및 캡스톤디자인	3(4)	이론및실습	
	ASPE415	원자층 증착장비이론 및 실습	3(4)	이론및실습	
	ASPE416	MI장비이론 및 캡스톤디자인	3(4)	이론및실습	

이수 구분	학수번호	교과목명	학점 (시간)	이론/실습	비고
	ASPE417	인공지능응용 MI장비이론 및 실습	3(4)	이론및실습	
	ASPE418	Test장비이론 및 캡스톤디자인	3(4)	이론및실습	
	ASPE419	차세대노광장비이론 및 실습	3(4)	이론및실습	
	ASPE420	센서이론과 실제	3(4)	이론및실습	
	ASPE422	플라즈마 source 이론	3(4)	이론및실습	
	ASPE424	반도체공정소재 및 캡스톤디자인	3(4)	이론및실습	
	ASPE431	프로젝트학기 I	3(10)	프로젝트학기	
	ASPE432	프로젝트학기 II	3(10)	프로젝트학기	
	ASPE433	프로젝트학기 III	3(10)	프로젝트학기	
	ASPE434	프로젝트학기 IV	3(10)	프로젝트학기	
	ASPE441	응 .복합연구형 국외 프로젝트학기I	3(10)	프로젝트학기	
	ASPE442	응 .복합연구형 국외 프로젝트학기 II	3(10)	프로젝트학기	
	ASPE443	응 .복합연구형 국외 프로젝트학기 III	3(10)	프로젝트학기	
	ASPE444	응 .복합연구형 국외 프로젝트학기 IV	3(10)	프로젝트학기	

- 총 요구학점 : 36학점 (전공필수 : 12학점, 전공선택 : 24학점)
  - 전공필수 : 5과목중 4과목 이수. 초과학점의 경우 전공선택으로 인정
- 반도체기업 인턴십 160시간 이상 이수(비교과) 혹은 KUS 전공특화현장실습I ~ KUS 전공특화현장실습VI (반도체관련 기업 현장실습에 한함) 3학점 이상 이수